

特色

创新的设计和大量封装解决方案提供原型到生产的平台。

- ▶ 定制焊球数量多至 814
- ▶ 0.80-1.27毫米焊球节距
- ▶ 21-35 毫米封装尺寸
- ▶ 提供细金线和铜线
- ▶ 芯片堆叠(CoC)
- ▶ 优化质量的大型模塑盖
- ▶ 轻薄型
- ▶ 改善热性能和电性能优化
- ▶ 高度灵活的内部信号、电源和接地布线，提升设备性能和系统兼容性
- ▶ HDI 设计
- ▶ 适用于多晶粒 (MCM) 和集成 SMT 结构的合适基板
- ▶ 基于成熟条带的高良率制程
- ▶ 外围、交错行和完全球栅阵列选项
- ▶ 多层布线, 良好的电源/地特性
- ▶ 出众的可靠性
- ▶ 无铅焊球

PBGA

J-Devices 的塑料球栅阵列 (PBGA) 封装专为高性价比的应用量身定制，能被灵活、有效地在基板上运用。I/O 能力提升，以及电源、接地和信号迹线的布线更加直接，使 PBGA 设计具有低电感、热性能提升，SMT 能力优化等特点，而且在电反应方面的表现也有显著的改善。

热性能优化 PBGA (TEPBGA)

此 PBGA 选项内置散热片，适用于对散热要求较高的应用。

应用

- ▶ 电视、游戏、个人电脑、网络、汽车和工业应用
- ▶ 需要多引脚、高密度、高散热和更高电性能的应用

热性能

封装尺寸 (mm)	1.0W 0 气流 (°C/W) 时的 θ_{JA}	
	PBGA	TEPBGA
23	18.6	14.2
27	16.9	13.7
31	16.0	12.4
35	15.5	11.9

*提供更多热数据
 *8.0 x 8.0 毫米的晶粒尺寸
 *0.29 毫米的晶粒厚度
 *环境温度 25°C

可靠性认证

- ▶ 湿敏性：预处理 30°C/60% 相对湿度，192 小时，IR 回流焊 260°C 3X
- ▶ uHAST：130°C/85% 相对湿度，96 小时
- ▶ 温度循环 -55°C/+125°C，1000 次循环
- ▶ 高温储存：150°C，1000 个小时

工艺亮点

- ▶ 晶粒厚度：0.29 毫米
- ▶ 焊盘节距：40 微米
- ▶ 金线直径：15-23 微米
- ▶ 铜线直径：18-23 微米
- ▶ 打标：激光打标
- ▶ 晶圆背面研磨：支持

PBGA

标准材料

- ▶ 封装基板
 - ▷ 导线：铜
 - ▷ 电介质：玻璃增强环氧树脂
- ▶ 晶粒贴装：导电性环氧树脂
- ▶ 模塑化合物：环氧树脂模塑化合物
- ▶ 焊球：无铅

测试服务

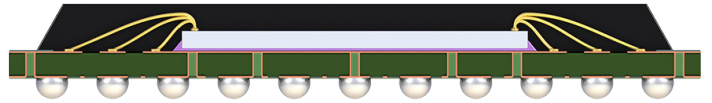
- ▶ 程序转换
- ▶ 产品工程
- ▶ 晶圆探针测试
- ▶ 具有 256 个引脚 x 20 MHz 测试系统
- ▶ 可提供 -55°C 至 +125°C 测试
- ▶ 耐老化性能

装运

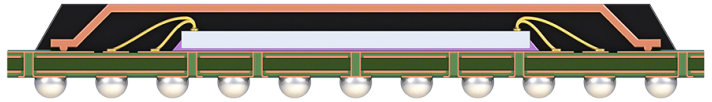
- ▶ JEDEC 外形托盘
- ▶ 卷带式包装

横截面

PBGA

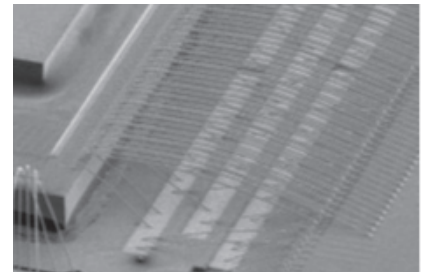
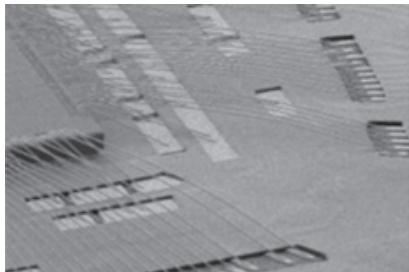


TEPBGA



J-Devices 的 TEPBGA 可将芯片的热量直接传递给散热片。这使热量在封装中传递，有更高的散热效率。

焊线图片



访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。

关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2018 Amkor Technology Incorporated. 保留所有权利。DSJD401C 修改日期：10/18

